

Compression Molding System

Model CPM1180



**Compression molding system
for large size PLP molding to meet industry needs**

用于大尺寸PLP成型的压缩成形系统， 满足行业需求

产品信息



中文

- 超大基板 最大660mm×620mm的自动成型可能
- 采用最合适的成形技术进行大型面板级封装
- 应用Cavity Down构造实现超大尺寸panel的高品质化
- 通过颗粒树脂的均匀分撒来实现成型品质的安定化
- 可通过增设或减少模组的方式灵活应对产能变化



SPECIFICATION

Items		Unit	Description			
机型		—	CPM1180			
设备区分		—	Manual	Semi-Auto	Full-Auto	
面板・晶圆类型		—	面板・晶圆			
面板・晶圆尺寸	面板	mm	625 × 620 (Max. 660 × 620)			
	晶圆	mm	φ 450 (Max.)	—	—	
树脂		—	颗粒			
机械时间		sec	—	—	Approximately 75	
外形尺寸	模组数量	module	1	1	1	2
	宽度	mm	2,000	4,395	7,050	8,990
	纵深	mm	2,670	2,670	3,750	3,750
	高度	mm	2,285	2,285	2,285	2,285
重量		ton	12.3	18.6	23.0	35.0
每模成形面板数量		workpiece	1	1	1	2
料盒放置空间		—	—	—	FOUP Input/Output stage : 1 cassette each In/Out stage : Panel 1 by 1	
合模压力		kN／(tf)	49.0—1,764.0／5.0—180.0			
合模速度		mm／sec	70 (Max.)			
品种切换方式		—	—	采用KIT更换方式		
使用分离膜的宽度		mm	740 (Max.)			

- 以上数据为本公司标准机型时的规格
- 以上规格根据实际需要有可能变更
- 如有其他特殊规格要求，另行协商



东和半导体设备（上海）有限公司
中国上海市普陀区凯旋北路1188号环球港B座20A
TEL 021-6888-6860

Website



Inquiry contact



TOWA（本公司商标），是TOWA株式会社的商标或注册商标。

Overseas Sales Contacts

Japan/Headquarters

TOWA Corporation

China

TOWA (Shanghai) Co., Ltd.
TOWA Taiwan Co., Ltd.

Korea

TOWA Korea Co., Ltd.

Singapore

TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

Malaysia

TOWA MALAYSIA SALES
& SERVICES SDN. BHD.

Philippines

TOWA Semiconductor Equipment
Philippines Corp.

Thailand

TOWA THAI COMPANY LIMITED

India

TOWA SEMICONDUCTOR INDIA
PRIVATE LIMITED

Germany

TOWA Europe GmbH

Netherlands

TOWA Europe B.V.

the United States

TOWA USA Corporation

20250501-006-HQ